

Fachverband der
Elektro- und
Elektronikindustrie

Der neue European Chips Act – Resilienz & Zukunftspotenziale schaffen

Positionspapier

Mai 2026

Der neue European Chips Act – Resilienz & Zukunftspotenziale schaffen

Gemeinsam mit Europas Tech-Industrie die Zukunft gestalten

Globale Herausforderungen

Europas Technologiesektor steht durch die aktiv und gezielt betriebene Industriepolitik anderer Machträume, durch Abhängigkeiten in den Wertschöpfungsketten und durch Versäumnisse in der europäischen Industriepolitik zunehmend unter Druck. Damit läuft Europa Gefahr, die kontinuierliche Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit notwendigen Schlüsseltechnologien nicht (mehr) gewährleisten zu können. Die **Beherrschung von Schlüsseltechnologien** – dazu zählen Bereiche wie Mikroelektronik, Biotechnologie, Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Materialien – ist zu einem entscheidenden geopolitischen Faktor geworden. Mit der Überarbeitung des European Chips Act besteht die Chance, mithilfe einer umfassenden Technologiepolitik notwendige Wachstumsanreize zu schaffen.

Technologiepolitik: Die Versorgung mit Schlüsseltechnologien sicherstellen

Schlüsseltechnologien oder Key Enabling Technologies (KETs) sind Technologien, die Wachstum und Innovation in verschiedenen Wirtschaftsbereichen erst ermöglichen. Sie sind die Basis für die Anwendung anderer Technologien und treiben deren Weiterentwicklung deutlich voran. **Dadurch nehmen sie eine Schlüsselrolle bei der Entstehung neuer Märkte ein.** Prominentes Beispiel für eine Schlüsseltechnologie ist die Mikroelektronik – sie steuert so gut wie alle Geräte unseres Alltags, vom Smartphone über den Computer-Tomographen bis hin zum Auto. Abbildung 1 zeigt: Nahezu alle Anwendungsfelder unseres täglichen Lebens werden durch Halbleiter und deren Wertschöpfungskette ermöglicht – sie bilden die Basis für **über 50 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts**.¹ Sie schaffen damit die Voraussetzung für weitere Innovationen, welche wiederum von der Verfügbarkeit von Halbleitern abhängen. Dadurch erzielte die Branche **im Jahr 2025 ein Wachstum von 22 Prozent**, das entspricht 141 Mrd. Dollar mehr – mit der Aussicht auf weiteres Wachstum auf **2.000 Mrd. Dollar bis 2036**.²

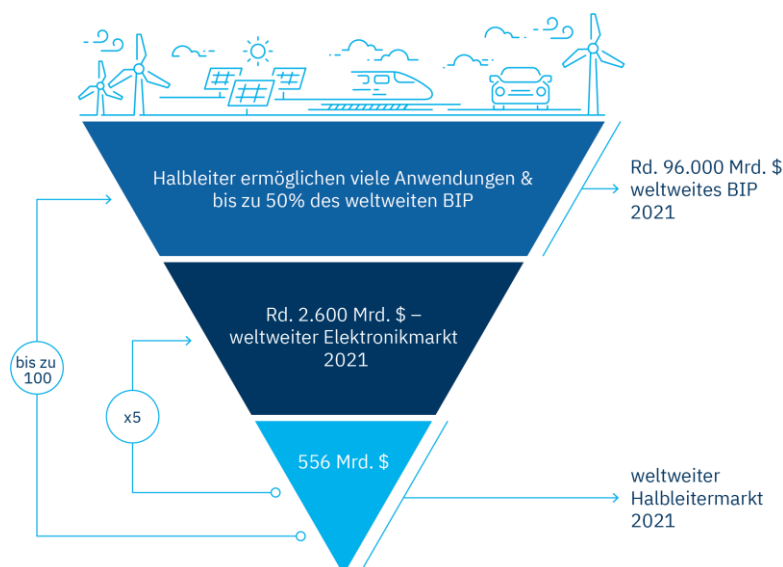


Abbildung 1: Der Halbleitermarkt ist die Basis eines Großteils des weltweiten BIP
Quellen: Economist Impact (2023), IMF (2024), ZVEI (2024), WSTS (2024)

¹ Driving development: The impact of ICT investments on the digital economy. Economist Impact (2023)

² 2026 global semiconductor industry outlook. Deloitte (2026)

Österreichs Mikroelektronik in der Pole-Position

Österreich hat eine außerordentlich hohe Dichte an Unternehmen im Bereich der Mikroelektronik, die entlang der Wertschöpfungskette hervorragend zusammenarbeiten, für hohe Wirtschaftsleistung sorgen und mit europäischen Partnern und Forschungseinrichtungen gut vernetzt sind. Damit nehmen Österreichs Unternehmen eine herausragende Rolle ein und sind in zentralen Technologiebereichen Weltmarktführer, wie ausgewählte Beispiele in Abbildung 2 zeigen.

Österreichs Unternehmen sind Weltmarktführer

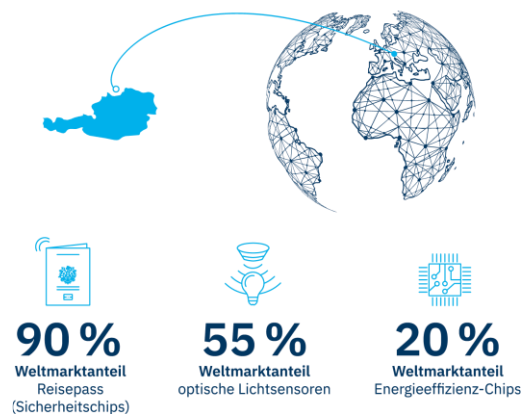


Abbildung 2: Österreichische Unternehmen sind in wichtigen Technologiefeldern herausragend.

Die harte Arbeit der letzten Jahre hat sich gelohnt

Der Output an elektronischen Bauelementen hat sich in den letzten zehn Jahren **versechsfacht**, während Österreichs Industrieproduktion gesamt um nur etwa 70 Prozent gewachsen ist. Die Zahl der Unternehmen in diesem Bereich stieg in den letzten 15 Jahren um 20 Prozent, die der Beschäftigten um 44 Prozent.³

Österreich ist Europas Nummer 1 im Bereich der elektronischen Bauelemente⁴ – in relativen Zahlen, bezogen auf die Größe des Landes, wie Abbildung 3 zeigt:

- Platz 1 hinsichtlich Anteile an Gesamtwertschöpfung.⁵
- Platz 1 hinsichtlich Anteile an der Gesamtbeschäftigung im Vergleich zu den anderen technologisch führenden Ländern.
- Platz 1 hinsichtlich Anteile in der unternehmerischen Forschung & Entwicklung.⁶



Abbildung 3: Österreich im Vergleich zu den EU-27 (diverse Quellen)

Österreich auf Augenhöhe mit großen EU-Ländern

In absoluten Zahlen belegt Österreich Platz 3 hinter Deutschland und Frankreich im Bereich der **F&E-Ausgaben** für elektronische Bauelemente.⁷ Gleichzeitig liegen die **Stärkefelder der österreichischen Unternehmen in geopolitisch strategischen Kompetenzfeldern:**

- **Leistungselektronik:** zur Erschließung des enormen Potenzials der erneuerbaren Energien.
- **Fortschrittliche**, in der westlichen Welt **einzigartige IC-Substrate** für führende Chipsystem-Architekturen wie KI-Chips und deren Infrastruktur.
- **Sensoren:** zur Aufnahme von Informationen für intelligente und autonome Systeme.

³ Langfristperspektiven für die österreichische Halbleiterindustrie und ihr FTI-Ökosystem. Dachs und Wasserbacher (2025) im Auftrag des BMIMI

⁴ Electronic Based Systems – Update der Daten zu Unternehmen. Hartmann (2023) im Auftrag des FEEI; verglichen wurden die europäischen Schlüsseltechnologieländer

⁵ Ebd.

⁶ The European Chips Act. Dachs (2023) im Auftrag des FIW; als Basis dienen Daten der OECD aus dem Jahr 2019

⁷ Langfristperspektiven für die österreichische Halbleiterindustrie und ihr FTI-Ökosystem. Dachs und Wasserbacher (2025)

- **Sicherheit in der digitalisierten Welt:** Technologien für sichere Identitätsdokumente, Bezahlsysteme (z.B. Pässe, Kreditkarten etc.).
- **Design:** sichere und zuverlässige Systeme zur Datenverarbeitung und Wahrung der Datenhoheit – zu finden in Produktions-, Mobilitäts- und Energiesystemen.
- **Hohe Wertschöpfungsdichte:** Schulterschluss verschiedener Technologiesegmente von Spezialmaschinen, Produktion, Leiterplatten & Packaging bis zur Spezialsoftware.
- **Fundiertes Grundlagen- & Anwendungswissen,** um hochkomplexe Systeme wirtschaftlich auf Spitzenniveau herstellen und entwickeln zu können.
- **Nachgelagerte Technologiebereiche:** In Form von Embedded Software von der Steuerung von Chips bis hin zu Systemanwendungen im Kommunikations- und Mobilitätsbereich (z.B. autonomes Fahren).

Gemeinsames zielorientiertes Handeln nötig

Um Österreichs hart erarbeitete Position in den genannten Technologiebereichen zu halten, muss der European Chips Act mit den Technologiepolitiken der USA und asiatischen Staaten im Mikroelektronikbereich bei Budgets, Prozessen und der strategischen Abstimmung mithalten können. Die USA und China verfügen über ziel- und anwendungsorientierte Programme⁸, mit denen die gesamte Wertschöpfungskette entwickelt wird. Die EU versucht mit einer Vielzahl von Rechtsakten und kleinteiligen Programmen dagegen zu halten – ein strategisch zielorientierter Ansatz fehlt jedoch.

Die 2023 zugesagten Fördermittel von rund 30 Mrd. EUR bis 2030 für den European Chips Act (ECA) waren ein guter erster Schritt – die zum überwiegenden Teil nationale Finanzierung macht das Gesetz im aktuellen Zustand aber zu langsam und ineffizient, um mit den agilen Industriepolitiken anderer Staaten mithalten zu können. Die Überarbeitung des European Chips Act als strategische Leitlinie bietet die einmalige Möglichkeit, Forschungsergebnisse rasch in Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Wohlstand umzusetzen und gleichzeitig die europäische Wirtschaft gegenüber anderen Machträumen resilienter zu gestalten.

FEEI-Empfehlungen

Der FEEI plädiert daher dafür, den **European Chips Act** als strategische Antwort Europas im globalen Wettbewerb **neu auszurichten, damit dieser auf EU- sowie auf nationaler Ebene kompetitiv dotiert und mit einer gesamteuropäischen Strategie rasch umgesetzt wird.**

Dazu braucht es:

- **Fest zugeordnete EU-Halbleiterbudgets:** 30 bis 60 Mrd. Euro über die nächsten sieben Jahre durch die EU, unterstützt durch 50 bis 60 Mrd. Euro durch die EU-Mitgliedsstaaten, ergänzt durch einen EU-Fonds mit 20 bis 30 Mrd. Euro für europäische Start- und Scale-Ups. Das Instrument „Tax-incentives“ sollte ebenso in Betracht gezogen werden, um kompetitive Rahmenbedingungen in Europa zu setzen.
- **Gesamtheitliche europäische Strategie für die Mikroelektronik in einem „Semiconductor Leadership Acceleration Plan“**, um
 - strategisch wichtige Stärkefelder auszubauen,
 - in zukünftigen Wachstumfeldern Technologieführerschaft zu erlangen,
 - sicherzustellen, dass innovative Durchbrüche auf europäischem Boden stattfinden,
 - Lücken bei der Versorgung mit Technologien und Vorprodukten durch internationale Partnerschaften oder gemeinsame Anstrengungen zu schließen,
 - innereuropäische Wettbewerbsverzerrungen durch Koordination zu vermeiden.
 - **Ziel: Europäische Technologien und Komponenten müssen in den Wertschöpfungsketten unverzichtbar werden.**
- Europa ist immer noch auf mittlere Technologiebereiche fokussiert, die im Vergleich zu hochtechnologischen Sektoren ein geringeres Wachstums- und Innovationspotenzial bieten.⁹ Der neue European Chips Act muss daher Teil einer **kohärenten industriepolitischen Strategie** sein:
 - **Europäische Großvorhaben** im Bereich **Künstliche Intelligenz** – wie etwa AI-Gigafactories – müssen konsequent europäische Anbieter, deren Schlüsseltechnologien

⁸ „Project Stargate“ der neuen US-Regierung (500 Mrd. USD an privaten Mitteln über vier Jahren für „AI made in the USA“); Made in China 2025 - erfolgreich; Verbindung von Forschung, procurement und Verteidigung (DARPA)

⁹ *Wirtschafts- und forschungspolitische Prioritäten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.* Mazak-Huemer und Reinstaller (2025)

- sowie bestehende EU-Initiativen (z.B. IPCEI) einbinden, um ein zukunftsfähiges und resilient verankertes KI-Ökosystem in Europa zu etablieren.
 - **IPCEIs** müssen als (ein) **Instrument zur Umsetzung des European Chips Act** gesehen werden.
 - Wertschöpfungsketten breiter denken: Eine **Verbindung zu Rechtsakten** wie dem Critical Raw Materials Act und dem Industrial Accelerator Act ist notwendig.
- Um die Nachfrage nach europäischen Schlüsseltechnologien gezielt zu stärken, muss die **öffentliche Beschaffung konsequent als industriepolitischer Hebel** genutzt werden – insbesondere durch Anwendung des Bestbieterprinzips sowie dem Ausschluss von nicht-vertrauenswürdigen Anbietern in kritischen Infrastrukturen und strategisch wichtigen Bereichen. Damit wird ein europäischer Markt im Sinne von „**Made in Europe and Partner Countries**“ geschaffen, der resilientere Wertschöpfung ermöglicht und Investitionen fördert.
- Umsetzung einer „project time to contract“ – Zeitspanne von Bedarfserhebung bis Finalisierung eines Projekts – von sechs Monaten durch die EU-Kommission.
- Schaffung und Nutzung von Seed- und Pre-Seed-Finanzierungsinstrumenten, vorkommerzieller Beschaffung, Nachfragebündelung sowie der Kombination von European Chips Act-Förderungen mit anderen Programmen wie InvestEU, damit europäische Start-Ups schnell wachsen können.¹⁰
- Eine **gemeinsame Arbeitsgruppe aller** am European Chips Act beteiligten **EU-Generaldirektionen**.
- Eine dauerhafte und systematische Einbindung der europäischen Industrie in die Halbleiterpolitik – hier muss vor allem bei der Abstimmung von Maßnahmen mit Chips JU¹¹ sowie bei der Einbindung österreichischer Leitbetriebe nachgebessert werden.
- **Eingliederung Österreichs in eine europäische Strategie** unter Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen Stärken und in Koordination mit den europäischen Partnern.
- **Vorkehrungen für nationale Ko-Finanzierung** von Produktionsvorhaben auf EU-üblichem Niveau in Österreich für Investitionen von Unternehmen („first of a kind“ entsprechend Chips Act I).
- **25 Mio. Euro pro Jahr (bis 2028) für den Forschungsbereich (Säule 1) des European Chips Act** sowie eine explizite Festlegung des Budgets in der Schwerpunktsetzung des Fonds Zukunft Österreich bis 2031.

Über den FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen des zweitgrößten Industriezweigs mit rund 300 Unternehmen, rund 72.500 Beschäftigten und einem Produktionswert von 23,43 Milliarden Euro (Stand 2024). Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern – dazu gehören u. a. die Fachhochschule Technikum Wien, UFH, die Plattform Industrie 4.0, Forum Mobilkommunikation (FMK), der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) und der Verband der Bahnindustrie – ist es das oberste Ziel des FEEI, die Position der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken

Obmann: Ing. Wolfgang Hesoun

Geschäftsführerin: Mag. Marion Mitsch

Rückfragen:

DI Dr. Klaus Bernhardt, MBA

GF-Stv., Leiter Forschung & Innovation, Energie & Infrastruktur

T +43/1/588 39-32

E bernhardt@feei.at

¹⁰ *European Chips Act 2.0 – Industry Policy Blueprint for Semiconductor Sovereignty, Competitiveness and Resilience*. Industry Advisory Group (2026)

¹¹ *Ebd.*